

Pâte thermoconductrice GD66, 0.5g

Référence AM7324

EAN13 : -

CUP : 38249996

Attributs du produit :

caractéristiques du produit :

Couleur: Gris

Max. température de fonctionnement: 200°C

Conductivité thermique: 1.05W/mK



Description du produit :

Pâte conductrice de chaleur de haute qualité pour les dissipateurs thermiques avec une conductivité thermique allant jusqu'à 1,05W/mK. La pâte thermique est conçue pour assurer un meilleur transfert de chaleur entre la source de chaleur - le composant électronique et son dissipateur thermique. Il comble les inégalités entre la surface du dissipateur thermique et la surface du composant refroidi et augmente ainsi le transfert de chaleur vers le dissipateur thermique, qui présente alors une plus grande efficacité de refroidissement. En utilisant une pâte conductrice de chaleur, vous améliorerez l'efficacité globale du refroidissement et prolongerez la durée de vie des composants refroidis. Convient à tous les semi-conducteurs (LED), processeurs, cartes graphiques, modules de mémoire et autres. La pâte n'est pas conductrice d'électricité.

Conductivité thermique : 1,05W/mK

Température minimale de fonctionnement : -50°C

Température maximale de fonctionnement : 200°C

Gravité spécifique :

